

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 3 区分

【発行日】平成22年10月14日 (2010.10.14)

【公表番号】特表2010-509655(P2010-509655A)

【公表日】平成22年3月25日 (2010.3.25)

【年通号数】公開・登録公報2010-012

【出願番号】特願2009-535264(P2009-535264)

【国際特許分類】

G 0 8 B 13/12 (2006.01)

【 F I 】

G 0 8 B 13/12

【手続補正書】

【提出日】平成22年8月24日 (2010.8.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 5 】

又、図 4 A 及び図 4 B には、センサ 1 0 の外部の別のデバイスと回路ボード 2 0 との結合を許容するべく好ましくはセンサ 1 0 内に含まれるセンサ 1 0 内の開口部 2 0 \_\_も示されている。外部デバイスは、例えば、コンピュータマザーボード、コネクタ、又はケーブルであってよい。図 5 は、開口部 2 0 \_\_によって構成要素 2 1 をコネクタ 8 0 に結合させることが可能であるような例示用の実施例を示す。又、図 4 A 及び図 4 B には、基板 1 1 から伸びる I / O リード 4 0 も示されている。図 6 は、開口部 2 0 \_\_が形成されていない例示用のセンサ 1 0 の平面図である。この図 6 のセンサ 1 0 は、図 2 B に示されているように、ケーブルを使用し、重複部分のゾーンを介して接続されることになるであろう。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

( a ) 回路ボードと、

( b ) ( i ) 第 1 面及び第 2 面を有する基板と、 ( i i ) 前記第 1 面上の導電トレースの第 1 レイヤとを有する不正開封反応型センサとを備え、

( c ) 前記不正開封反応型センサは、少なくとも 1 つの重複領域を有する状態で前記回路ボードの周囲に巻き付けられており、

( d ) 前記不正開封反応型センサは、前記少なくとも 1 つの重複領域においてのみ、前記第 2 面上の導電トレースの第 2 レイヤを有することを特徴とする物品。

【請求項 2】

前記基板は、不透明な絶縁フィルムである請求項 1 記載の物品。

【請求項 3】

前記基板は、P E T である請求項 1 記載の物品。

【請求項 4】

前記第 1 レイヤは、前記回路ボードに隣接する請求項 1 記載の物品。

【請求項 5】

前記基板及び前記エンクロージャは、前記回路ボードと外部デバイスとの間における通信の開口部を更に有する請求項 1 記載の物品。

【請求項 6】

前記外部デバイスは、印刷回路ボードである請求項 5 記載の物品。

【請求項 7】

前記物品は、前記回路ボードに装着され、且つ、前記開口部内に配設されたコネクタを更に有する請求項 5 記載の物品。

【請求項 8】

前記物品は、前記回路ボードに装着され、且つ、前記開口部内に配設されたケーブルを更に有する請求項 5 記載の物品。

【請求項 9】

前記回路ボードは、無線送信機を有する請求項 1 記載の物品。

【請求項 10】

前記不正開封反応型センサは、前記少なくとも 1 つの重複領域に前記基板の 2 つのレイヤのみが存在するように成形される請求項 1 記載の物品。

【請求項 11】

前記不正開封反応型センサの前記基板の前記第 2 面は、露出した導電トレースを有していない請求項 1 記載の物品。

【請求項 12】

前記不正開封反応型センサの前記基板は、接着剤を更に有する請求項 1 記載の物品。

【請求項 13】

前記接着剤は、前記導電トレースの第 1 レイヤ ( 14 ) 又は前記導電トレースの第 2 レイヤ上に配設される請求項 12 記載の物品。

【請求項 14】

前記接着剤は、P S A である請求項 12 記載の物品。

【請求項 15】

( a ) 第 1 面及び第 2 面を有する基板であって、前記第 2 面の重複部分と共に前記第 1 面の重複部分を生成するように折り曲げられるべく構成された基板と、

( b ) 前記第 1 面上の導電トレースの第 1 レイヤと、

( c ) 前記第 2 面の前記重複部分のみにおける導電トレースの第 2 レイヤとを有しており、

( d ) 前記第 2 面は、導電トレースが存在しない領域を有し、

( e ) 前記導電トレースの第 2 レイヤは、前記導電トレースの第 1 レイヤに電氣的に接続されることを特徴とする不正開封反応型センサ。

【請求項 16】

前記基板は、不透明である請求項 15 記載の不正開封反応型センサ。

【請求項 17】

前記基板は、絶縁性を有する請求項 15 記載の不正開封反応型センサ。

【請求項 18】

前記基板は、P E T である請求項 15 記載の不正開封反応型センサ。

【請求項 19】

前記基板は、接着剤を更に有する請求項 15 記載の不正開封反応型センサ。

【請求項 20】

前記接着剤は、前記導電トレースの第 1 レイヤ上に配設される請求項 19 記載の不正開封反応型センサ。

【請求項 21】

前記接着剤は、P S A である請求項 19 記載の不正開封反応型センサ。

【請求項 22】

前記不正開封反応型センサは、開口部を更に有する請求項 15 記載の不正開封反応型センサ。

## 【請求項 2 3】

前記導電トレースは、予測不可能なパターンを有する請求項 1 5 記載の不正開封反応型センサ。

## 【請求項 2 4】

前記不正開封反応型センサは、I/O リードを更に有する請求項 1 5 記載の不正開封反応型センサ。

## 【請求項 2 5】

前記不正開封反応型センサは、前記導電トレースの第 1 レイヤを前記導電トレースの第 2 レイヤに接続するための少なくとも 1 つのビアであって、前記重複部分において前記基板を貫通した少なくとも 1 つのビアを更に有する請求項 1 5 記載の不正開封反応型センサ。

## 【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 4 A

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 4 A】

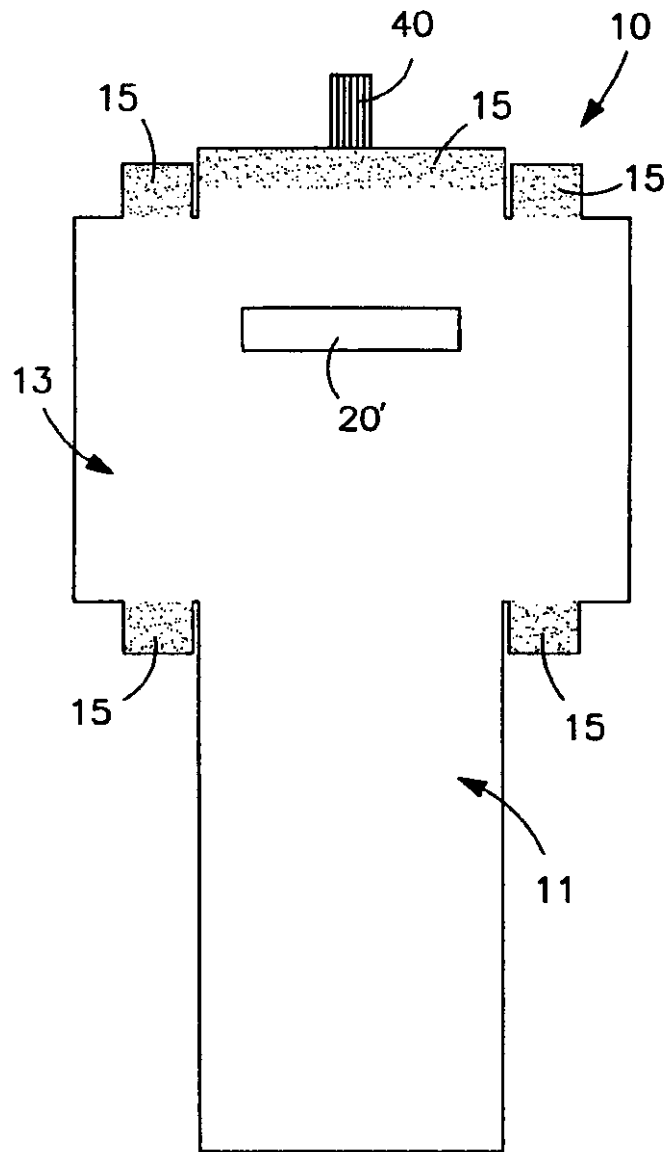


FIG. 4A

【手続補正 4】

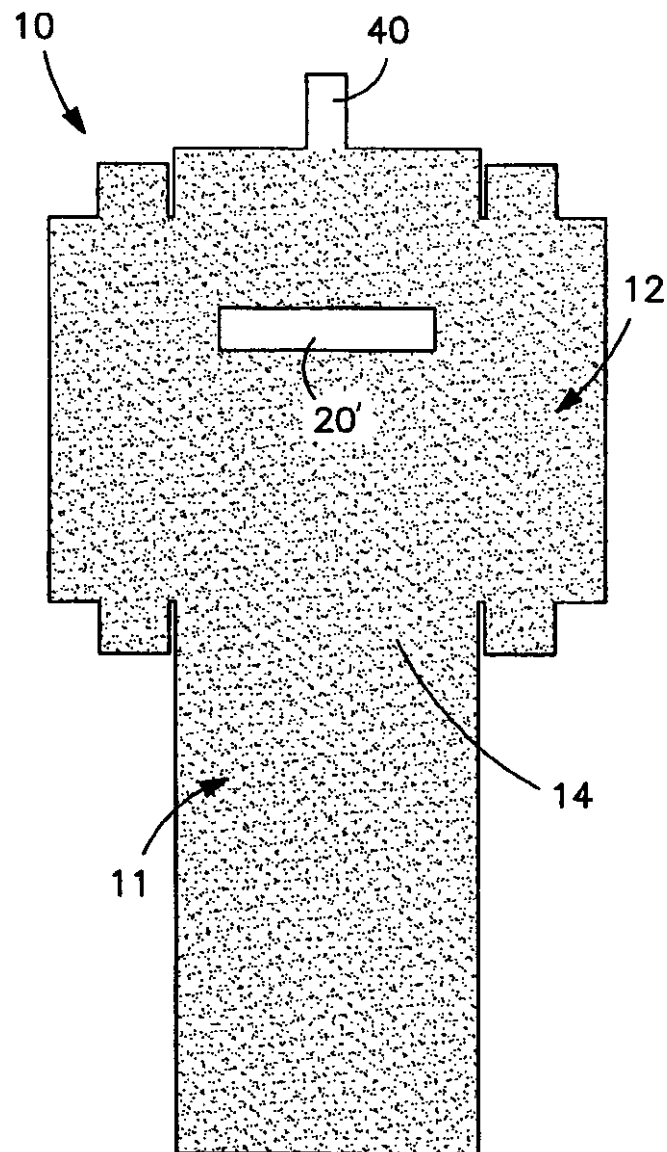
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 4 B

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 4 B】

**FIG. 4B**

【手続補正 5】

【補正対象書類名】図面  
【補正対象項目名】図 5  
【補正方法】変更  
【補正の内容】

【図 5】

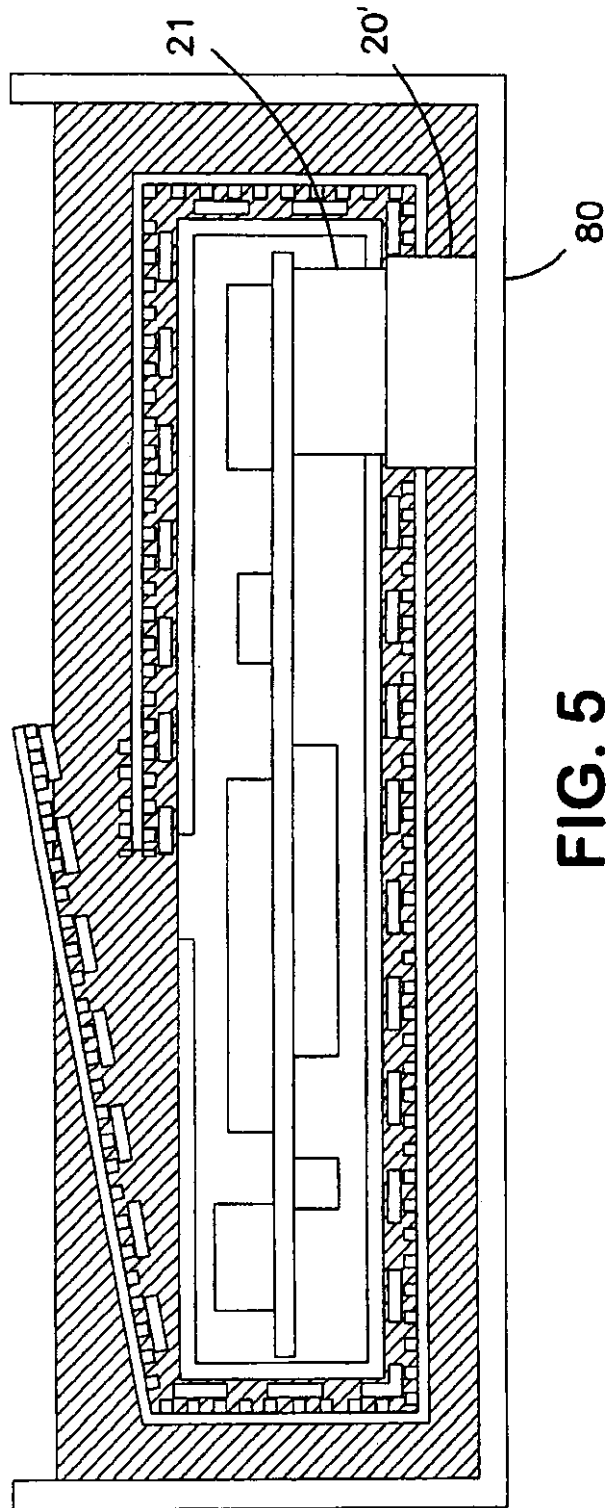


FIG. 5